



2023年11月28日

各位

会社名 カーリットホールディングス株式会社
(URL : <https://www.carlithd.co.jp>)
代表者名 代表取締役兼社長執行役員 金子 洋文
(コード番号 4275 東証プライム)
問合せ先 広報・サステナビリティ推進室長 島田 拓
(TEL : 03-6893-7060)

完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）
ならびに商号等変更のための定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年9月26日付で、2024年7月1日を目処に純粋持株会社体制を解消し、当社の完全子会社である日本カーリット株式会社（以下「日本カーリット」といいます）および株式会社シリコンテクノロジー（以下「シリコンテクノロジー」といいます）の吸収合併の検討およびその準備を開始することを決議した旨を公表しております。

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、当社の完全子会社である日本カーリットおよびシリコンテクノロジーを、2024年10月1日を効力発生日として吸収合併（以下「本合併」といいます）することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、本合併に先立ち、2024年6月27日開催予定の定時株主総会で定款の一部変更が承認されることを条件として、2024年7月1日付で商号を「株式会社カーリット」に変更する予定です。定款の一部変更議案については取締役会で決議次第開示いたします。

なお、本合併は、いずれも当社の完全子会社を対象とする吸収合併であることから、開示事項および開示内容を一部省略しております。

記

I. 合併について

1. 合併の目的

当社グループは、2013年10月以降、純粋持株会社体制のもと、グループの競争力強化や成長促進を図るべく取組んでまいりました。当初の目的の通り持株会社体制により経営と事業運営を分離し、グループ経営という視点での全体最適を図りながら、既存事業の構造改革や財務体質の改善などの経営課題に取り組むことで、現在これらの課題の克服については一定の目途をつけることができました。

その上で、2022年度から開始した中期経営計画「Challenge2024」における「2030年のありたい姿」の達成、並びにPBR改善を目的とし、「事業インフラの再構築」戦略の一環として意志決定の迅速化・管理部門スリム化・人員リバランス等を行うためには、グループの組織体制を変更することが最適であると判断いたしました。

具体的には、現在の純粋持株会社体制から事業持株会社体制へ移行し、同中期経営計画に掲げる事業ポートフォリオにおける注力・育成領域を基軸に、日本カーリットとシリコンテクノロジーを当社に合併し、経営体制を一体化することで、成長戦略の推進と経営の効率化を図るものです。

2. 合併の要旨

① 合併効力発生日の変更

変更前	変更後
2024年7月1日(予定)	2024年10月1日(予定)

② 合併効力発生日の変更理由

2023年9月26日付の開示において、合併の効力発生日は2024年7月1日を予定しておりましたが、日本カーリット(株)および(株)シリコンテクノロジーが保有する火薬類や危険物・化学品の製造・販売の許認可の承継等に関連した事務手続き等に当初の見込み以上の期間を要することや、取引先への影響を最小限にすべく万全を期す必要性から、2024年10月1日に延期することといたしました。

③ 合併の日程

純粋持株会社体制解消に向けた準備開始の決議	2023年9月26日
合併決議取締役会	2023年11月28日
合併契約締結日	2023年11月28日
合併効力発生日	2024年10月1日(予定)

※本合併は、当社においては会社法第796条第2項本文に定める簡易合併であり、日本カーリットおよびシリコンテクノロジーにおいては会社法第784条第1項本文に定める略式合併であるため、いずれも合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく実施します。

④ 合併の方式

当社を存続会社とし、日本カーリットおよびシリコンテクノロジーを消滅会社とする吸収合併をいたします。

⑤ 合併に係る割当ての内容

日本カーリットおよびシリコンテクノロジーは、当社の完全子会社であるため、本合併に際して新株式の発行および金銭その他の交付は予定しておりません。

⑥ 合併に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併の当事会社の概要

別紙1の通りです。

4. 合併後の状況等

本合併に先立ち、当社商号を下記Ⅱのとおり変更するほか、本合併後は、当社は純粋持株会社から事業持株会社となることから、当社の事業内容を追加するため、下記Ⅲのとおり定款の一部変更を行います。その他、本合併後における、所在地、代表者名の役職・氏名、資本金および決算期の変更はございません。

5. 今後の見通し

本合併は、完全子会社との合併であるため、当社グループの連結業績への影響は軽微です。なお、連結業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には、速やかにお知らせいたします。

II. 商号変更について

1. 変更の理由

本合併に先立ち、純粋持株会社を解消し事業持株会社へ移行することに伴い、当社創業来お客さまに慣れ親しんでいただいている「カーリット」という名称を残し守り続けることで、これまで培ってきた経営理念「信頼と限りなき挑戦」のもと、中期経営計画「Challenge2024」および「2030年のありたい姿」の実現に向け、当社グループのイメージを刷新し企業価値向上を図っていきたいという思いを込めております。

2. 新商号（英文表記）

株式会社カーリット（英文：Carlit Co., Ltd.）

3. 新商号変更日

2024年7月1日（予定）

注：本商号変更は、2024年6月27日開催予定の定時株主総会で定款の一部変更が承認されることを条件とします。

III. 定款一部変更について

1. 変更の目的

当社は、上記Ⅱの商号変更を行うとともに、純粋持株会社から事業持株会社に移行することに伴い事業目的を変更します。

2. 変更の内容

- ① 商号の変更（当社定款第1条）
- ② 事業目的の変更（当社定款第2条）

詳細は別紙2の通りです。

3. 変更の日程

定 時 株 主 総 会 開 催 日	2024年6月27日（予定）
定 款 一 部 変 更 の 効 力 発 生 日	2024年7月1日（予定）

以上

(別紙 1 : 本合併の当事会社の概要)

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社	吸収合併消滅会社
(1) 商号	カーリットホールディングス株式会社	日本カーリット株式会社	株式会社シリコンテクノロジー
(2) 本店所在地	東京都中央区京橋一丁目17番10号	東京都中央区京橋一丁目17番10号	東京都中央区京橋一丁目17番10号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役兼社長執行役員 金子 洋文	代表取締役兼社長執行役員 小川 文生	代表取締役社長 山口 容史
(4) 主な事業内容	化学品、ボトリング、金属加工、エンジニアリングサービス事業等を行う子会社等の経営管理およびそれに附帯または関連する業務	化学品、電子材料品等の製造および販売	半導体用シリコンウェーハ製造、販売
(5) 資本金	2,099 百万円	1,204 百万円	450 百万円
(6) 設立年月日	2013 年 10 月 1 日	1934 年 3 月 24 日	1994 年 12 月 15 日
(7) 発行済株式数	24,050,000 株	20,600,000 株	9,000 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率 (2023 年 9 月 30 日時点)	日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 11.10% みずほ信託銀行(株) (丸紅口) 8.3% 日油(株) 3.8% みずほ信託銀行(株) (みずほ銀行口) 3.8% 長瀬産業(株) 2.9% 明治安田生命保険相互会社 2.9%	カーリットホールディングス株式会社 (100%)	カーリットホールディングス株式会社 (100%)
(10) 直前事業年度の財政状態および経営成績			
	2023 年 3 月期 (連結)	2023 年 3 月期 (単体)	2023 年 3 月期 (単体)
純資産	33,179 百万円	13,522 百万円	821 百万円
総資産	51,230 百万円	25,324 百万円	2,820 百万円
1 株当たり純資産	1,402 円 70 銭	656 円 45 銭	91,231 円 62 銭
売上高	36,008 百万円	17,078 百万円	2,263 百万円
営業利益	2,640 百万円	1,315 百万円	259 百万円
経常利益	2,910 百万円	1,366 百万円	248 百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,246 百万円	953 百万円	179 百万円
1 株あたり当期純利益	94 円 55 銭	46 円 28 銭	19,990 円 88 銭

(別紙 2 : 定款新旧対照表)

(下線部分は変更箇所を示しております)

現行定款	定款変更案
<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>カーリットホールディングス株式会社</u>と称し、英文では、<u>Carlit Holdings Co., Ltd.</u>と表示する。</p>	<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>株式会社カーリット</u>と称し、英文では、<u>Carlit Co., Ltd.</u>と表示する。</p>
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(新設)</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p><u>(1) 爆薬、火工品その他一般火薬類の製造および売買</u></p> <p><u>(2) 塩素酸塩類、亜塩素酸塩類、過塩素酸塩類その他一般化学工業品の製造および売買</u></p> <p><u>(3) 農薬、農業資材の製造および売買</u></p> <p><u>(4) 電子部品ならびに電子部品の原材料の製造および売買</u></p> <p><u>(5) 機能性材料の製造および売買</u></p> <p><u>(6) 試薬および医薬部外品の原材料の製造および売買</u></p> <p><u>(7) 研削材その他一般電気化学工業品の製造および売買</u></p> <p><u>(8) 化学機械器具ならびに装置類の設計、製作、据付、売買、賃貸および技術指導</u></p> <p><u>(9) 建築物、電気工作物ならびに配管施設の設計、施工および工事監理</u></p> <p><u>(10) 自然エネルギー等による発電事業およびその管理、運営ならびに電気の売買</u></p> <p><u>(11) 産業廃棄物の収集、運搬、処理および再生</u></p> <p><u>(12) 危険性評価試験受託および関連するサービス業ならびにコンサルティング業</u></p> <p><u>(13) 直流電圧、直流電流の発生装置および測定装置等の校正受託サービス業ならびにコンサルティング業</u></p> <p><u>(14) 二次電池の受託試験サービス業ならびにコンサルティング業</u></p> <p><u>(15) 電子部品用等シリコン材料の製造、加工及び売買</u></p> <p><u>(16) 光学用機器、半導体用部品・治具の製造及び売買</u></p> <p><u>(17) 半導体、電子部品の再生、加工及び売買</u></p>

<p><u>(1)</u> 各種事業を営む国内外の会社の株式・持分を取得・譲渡・所有することによる当該会社の事業活動の支配・管理</p> <p><u>(2)</u> 各種事業を営む国内外の会社に対する経営の指導・支援・管理、および経理、総務、人事、研究開発等の業務の支援・管理</p> <p><u>(3)</u> 知的財産権の取得・維持・譲渡・許諾、および不動産の取得・譲渡・貸与・管理運用</p> <p><u>(4)</u> 金銭の貸付、借入に対する保証</p> <p><u>(5)</u> 前各号に付帯関連する事業</p> <p><u>(6)</u> 各種事業</p>	<p><u>(18)</u> 半導体製造装置、精密機器・装置の製造及び売買</p> <p><u>(19)</u> 一般貨物自動車運送事業ならびに倉庫業</p> <p><u>(20)</u> 各種事業を営む国内外の会社の株式・持分を取得・譲渡・所有することによる当該会社の事業活動の支配・管理</p> <p><u>(21)</u> 各種事業を営む国内外の会社に対する経営の指導・支援・管理、および経理、総務、人事、研究開発等の業務の支援・管理</p> <p><u>(22)</u> 知的財産権の取得・維持・譲渡・許諾、および不動産の取得・譲渡・貸与・管理運用</p> <p><u>(23)</u> 金銭の貸付、借入に対する保証</p> <p><u>(24)</u> 前各号に付帯関連する事業</p> <p><u>(25)</u> 各種事業</p>
--	--